

RoHS-Richtlinie für Leiterplatten

Bereits seit dem Jahr 2000 befasst sich MicroCirtec Micro Circuit Technology GmbH mit der Umsetzung der RoHS-Richtlinie, welche die Verwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen, wie den Einsatz der Schwermetalle Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom sowie den Flammhemmer polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromierter Diphenylether (PBDE) in Elektro- und Elektronikgeräten beschränkt.

Die Vorschrift gilt seit dem 1. Juli 2006 für neu in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte. Seit Februar 2004 liefert MicroCirtec RoHS-konforme Leiterplatten in verschiedenen Oberflächenveredelungen, unter anderem auch Hot-Air-Leveling in bleifreier Verzinnung.

Wir bestätigen, dass die von uns gelieferten Leiterplatten konform mit der aktuellen EU Richtlinie 2011/65/EU RoHS sowie der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 sind.

RoHS-Konformität der Materialbestandteile im Basismaterial und Lötstopplack

Die RoHS-Konformität der Basismaterialien und der Lötstopplacke wird auch durch die Hersteller ohne Einschränkung bestätigt, da das in die Harzmatrix eingebundene Tetrabrombisphenol A (TBBA Flammhemmer) nicht in freier Form vorliegt, sondern durch chemische Reaktion bei der Harzherstellung in das Epoxidharz einreagiert ist.

Halogenfreies Basismaterial

Halogene sind z.B. die Elemente Brom Br, Chlor Cl, Fluor F und Jod I und sind oft als Bestandteil von organischen Verbindungen vorzufinden (PTFE, Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, PCB's, Chloroform, TBBA, Seveso-"Dioxin", etc.). Bei halogenfreien Basismaterialien werden als Flammhemmer Verbindungen aus Stickstoff und Phosphor eingesetzt.

Geschäftsleitung
gez. Andreas Brüggem

Geschäftsleitung
gez. Hildegard Völker

Seite 1 von 1